

高熱伝導性・高耐熱性 ポリマーコンポジット絶縁材料の開発と将来展望

日時 2016年6月22日(水) 13:00~16:30

主催 S&T出版株式会社

会場 高橋ビルディング (東宝土地(株)) 会議室 東京都千代田区神田神保町3-2

受講料 43,200円 (税込) ※Eメール案内会員価格 41,000円 ※資料代を含む

<1名様分の受講料で2名様まで受講できます。>

※2名様ご参加は同一会社・法人からの同時申込に限ります。

※2名様ご参加は2名様分の参加申込が必要です。ご連絡なく2名様のご参加はできません。

※3名様以上のご参加は、追加1名様あたり10,800円OFFになります。

講師 小迫 雄裕 氏 九州工業大学 大学院工学研究院 電気電子工学研究系電気エネルギー部門 准教授

申込受付は終了しました

高熱伝導性かつ電気絶縁性を両立する材料に対するニーズは高いが、相反する両特性の双方向上は容易では無い。本講演では、電気・電子部品の放熱・電気絶縁部材への応用を見据えた高熱伝導性複合絶縁樹脂の開発事例、新しい絶縁材料技術としてナノコンポジット、電界によるファイラー配置制御(異方性と傾斜機能性)、エポキシ代替材料の可能性としてポリトリシクロペンタジエンの開発状況等について紹介し、絶縁技術を将来展望する。

講演詳細

1. 有機/無機複合材料の基本

- (1) コンポジットとは?
- (2) 複合測とは?

2. ナノコンポジット絶縁材料研究動向

- (1) ナノコンポジットとは?
- (2) 現状の適用例は?
- (3) なぜナノコンポジットで特性改善するのか?
- (4) 世界的な研究動向は?

3. 研究成果紹介(基礎的特性と応用事例)

- ① ナノアルミナ被覆(電気絶縁化)
- ② ファイラー配向(高熱伝導化)
- ③ ナノコンポジット(電気絶縁性の向上)

④ 誘電率傾斜機能材料(電界緩和)

⑤ 高耐熱樹脂(ポリトリシクロペンタジエン)

⑥ 気泡含有樹脂(低誘電率化)

⑦ 量子化学計算の導入(解明と探索)

⑧ 絶縁信頼性評価のための部分放電測定

4. おわりに

セミナー申込用紙 セミナー名: ST160622-2(高熱伝導性・高耐熱性ポリマーコンポジット絶縁材料)

| | | | |
|---|----|---|--|
| 会社・団体名 | | TEL | |
| 住所 〒 | | FAX | |
| ① | 氏名 | 部署・役職 | |
| | | E-mail | |
| ② | 氏名 | 部署・役職 | |
| | | E-mail | |
| 支払方法 | | <input type="checkbox"/> 振込 <input type="checkbox"/> 当日現金 ※銀行振込の場合は振込予定日を記載ください 月 日 | |
| Eメール案内会員登録(無料) | | Eメール案内(無料)に <input type="checkbox"/> 登録する <input type="checkbox"/> 登録済み | |
| <small>※E-mailアドレスが必須です。 ※右記に✓印をつけてご登録いただくと、この申込からEメール案内会員価格で申込できます。 ※Eメールでセミナー書籍の最新情報をご案内致します。</small> | | 通信欄 | |

※上記ご記入の上、**FAX 03-3261-0238**までお申込みください。

■お申込み方法
必要事項をご記入の上、FAXでお申込みください。または当社ホームページからお申し込みください。

■受付完了のご連絡

受付完了後、3営業日以内に請求書、受講券、会場案内図を郵送いたします。※お申込み後7日以上経っても受講券・請求書がお手元に届かない場合は、弊社までご連絡ください。
セミナー申し込み後、受講をキャンセルされる場合は、必ず開催日前日から起算して10日前までにご連絡ください。それ以降のご連絡及び、当日欠席の場合、返金はいたしかねますので、代理の方のご出席をお願いいたします。代理の方も出席できない場合は資料の送付で出席をさせていただきます。受講料未入金のまま当日ご欠席されてもキャンセルにはなりません。全額請求させていただきますので予めご了承ください。

■お支払

銀行振込にてお願いいたします。
受講料のご入金は、開催日までをお願いいたします。やむなく開催日以降にご入金の場合は、当日現金でお支払またはお申込みの際に振込予定日をご記入ください。銀行振込の場合、領収証の発行はいたしません。

■個人情報取り扱い

ご記入の個人情報は、商品の発送、事務連絡、ご案内等に使用いたします。